

# 公司概况



AMKOR 的理念

## 我们通过帮助客户建立业务 构建自己的业务。

### 技术引领者

#### 我们是谁

Amkor 成立于 1968 年，不断的进步、发展和创新让我们成为超过 300 家全球领先半导体公司的战略及可靠的制造合作伙伴。我们的大容量专业制造技术和克服行业所面对技术挑战的能力是我们的最大优势。

客户对高精密产品的需求使半导体封装成为系统性能的关键因素。作为全球最大型的外包半导体先进封装设计、组装和测试服务的供应商之一，Amkor 帮助让创新技术变为现实。



#### 我们的产品组合

Amkor 提供超过 1,000 种不同的封装格式和尺寸。其产品涵盖通孔及表面贴装的传统引脚框架 IC 到最新的芯片尺寸封装 (CSP)，以及适用于多引线数量和高密度应用球栅阵列 (BGA) 解决方案。

我们的多样化产品组合包括堆叠晶粒、晶圆级、MEMS、倒装芯

片、硅通孔 (TSV) 和 2.5/3D 封装，让我们成为大量客户的单一供应商。我们能够满足从传统设备到系统级封装 (SiP) 解决方案的全部半导体封装需求。我们提供的优质封装服务让客户将资源集中投入到半导体设计和晶圆加工，并将我们视为封装技术的创新者与测试合作伙伴。

#### 加快上市时间

Amkor 经营场地的占地面积超过 1,100 万平方英尺，并配备了各种制造设备。我们的产品开发中心、销售和支持办事处战略性地分布在关键的电子设备制造区域。我们的客户能从我们大范围的全球分布中获益，让我们可以轻松处理大宗订单，并缩短周转时间。

#### 半导体 IC 封装设计服务

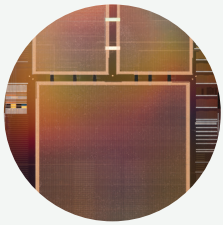
Amkor 与基板及软件供应商紧密合作，以推动新一代封装设计的发展。我们的设计工程师都是经过培训的专家，在最新设计工具和封装技术领域具备丰富的经验。这让我们的世界级设计中心能够缩短设计周期，并提供专业的建议。

# 产品与服务

## 封装

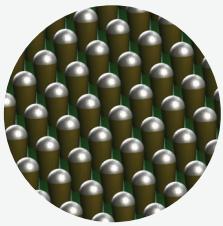
消费者要求以更低的成本在更小的空间内实现更多的功能与更优异的性能。Amkor 是打造半导体封装解决方案以满足此类复杂需求的行业领袖。

### 特色产品包括



#### 2.5/3D – 硅通孔

硅通孔 (TSV) 互连适用于各种 2.5D 和 3D 封装应用及架构。TSV 能够满足高性能、低能耗需求。



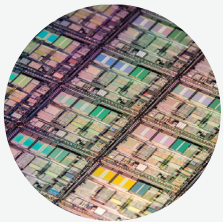
#### 倒装芯片

Amkor 致力于成为倒装芯片技术领域的重要提供商。我们的韩国、台湾和中国工厂具备倒装芯片制造能力。



#### 功率离散

专为功率敏感型及移动设备优化的 Amkor 高性能功率分立器件包括，先进电源封装、先进铜片附着和模块。



#### 系统级封装 (SiP)

随着对完整系统配置的意识不断提高，系统级封装 (SiP) 解决方案日益普及，行业要求以更低的成本实现更高级别的集成。



#### 晶圆级封装

从扇出式、芯片尺寸至系统级封装 (SiP)，Amkor 提供各种晶圆级封装和封装制程。

## 封装

凭借全球性的大容量制造能力，Amkor 可以组装各式各样的封装解决方案，包括采用无铅和绿色封装的焊线及倒装芯片等。

## 最终测试服务

Amkor 提供全部的半导体测试服务，包括各种类型的最后、系统级，晶圆和条带测试，以及包括最终装运在内的完整生产线末端服务。



我们为全球客户提供发展业务所需的电子元件。Amkor 能够提供卷带式封装、干燥包封装，以及仓储服务，并具备向世界各地直接待发货的能力。

## 为未来做准备

随着行业快速朝着先进的技术（如集成电路的 3D 堆叠）方向发展，芯片封装交互的复杂性越来越引人注目。各公司都期待 Amkor 能为其提供满足各种产品设计需求的端对端解决方案。

# 全球技术领导力

## 公司总部

Amkor Technology, Inc.  
2045 E Innovation Circle  
Tempe, AZ 85284  
USA  
电话：480.821.5000  
传真：480.821.8276

## 美国销售办事处

圣何塞，加利福尼亚州  
Amkor Technology, Inc.  
25 Metro Drive, Suite 700  
San Jose, CA 95110  
USA  
电话：408.496.0303  
传真：408.496.0392

欧文，加利福尼亚州  
Amkor Technology, Inc.  
16795 Von Karman Avenue  
Suite 260  
Irvine, CA 92606  
电话：949.724.9370  
传真：949.724.8925

圣地亚哥，加利福尼亚州  
Amkor Technology, Inc.  
5465 Morehouse Drive  
Suite 210  
San Diego, CA 92121  
电话：858.320.6280  
传真：858.622.1841

波士顿，马萨诸塞州  
Amkor Technology, Inc.  
105 Central Street  
Suite 2300  
Stoneham, MA 02180  
电话：781.438.7800  
传真：781.438.8414

奥斯汀，德克萨斯州  
Amkor Technology, Inc.  
8140 N. Mopac  
Suite 150  
Austin, TX 78759  
电话：512.953.0701  
传真：512.953.0717

## 欧洲、中东和非洲销售办事处

Amkor Technology Holding  
B.V., Germany  
Werner-Eckert-Straße 14  
81829 Munich  
德国  
电话：+49 (0) 89.1241498.40  
传真：+49 (0) 89.1241498.49

## 大中华地区销售办事处

Amkor Technology Shanghai  
中国上海浦东新区  
张江高科技园区  
金科路 2889 号  
长泰广场 E 座  
504 室，  
邮编 201203  
电话：86.21.50644590  
转 2340、4034、4221、4245  
传真：86.21.50482522

## 日本销售办事处

Amkor Technology Japan, Inc.  
Shiba-Koen Front Tower 14F  
2-6-3, Shibakoen  
Minato-ku, Tokyo 105-0011  
Japan  
电话：81.3.5425.2830  
传真：81.3.5425.2831

## 韩国销售办事处

Amkor Technology Korea, Inc.  
Songdo  
150, Songdomirae-ro  
Yeonsu-gu, Incheon 21991  
Korea  
电话：+8232.728.4114

## 东南亚销售办事处

Amkor Technology Singapore  
Holding Pte. Ltd.  
Valley Point Office Tower  
491B River Valley Road  
#12-03  
Singapore 248373  
电话：65.6211.3333  
传真：65.6211.3388

## 台湾销售办事处

Amkor Technology Taiwan Inc.  
台湾新竹县竹北市  
二街一號三樓之一  
邮编 302  
电话：+886.3.598.2000  
传真：+886.3.560.1269



访问 [amkor.com](http://amkor.com) 或发送电子邮件至 [sales@amkor.com](mailto:sales@amkor.com) 以获得更多信息。

关于本文档中的信息，Amkor 对其准确性或使用此类信息不会侵犯第三方的知识产权不作任何担保或保证。Amkor 对因使用或依赖它而造成的任何性质的损失或损害概不负责，并且不以此方式默示任何专利或其他许可。本文档不以任何方式扩展或修改 Amkor 其任何产品的标准销售条款和条件中规定的保修。Amkor 保留随时对其产品和规格进行更改的权利，恕不另行通知。Amkor 名称和标志是 Amkor Technology, Inc. 的注册商标。所提到的所有其他商标是各自公司的财产。© 2022 Amkor Technology, Incorporated. 保留所有权利。BR302G-CN 修改日期：01/22

